



2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月10日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 松村 晃文

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2023年11月10日

配当支払開始予定日

2023年12月7日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日～2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	819,572	30.7	178,578	49.0	181,282	48.7	137,491	48.6
2023年3月期第2四半期	1,182,897	26.9	350,165	27.5	353,319	27.2	267,346	33.5

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 179,672百万円 (30.9%) 2023年3月期第2四半期 259,972百万円 (15.8%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	295.13	294.12
2023年3月期第2四半期	571.76	569.28

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	2,191,741	1,530,272	69.2
2023年3月期	2,311,594	1,599,524	68.7

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 1,516,125百万円 2023年3月期 1,587,595百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期		857.00		854.00	1,711.00
2024年3月期		148.00			
2024年3月期(予想)				192.00	340.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

- 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。2023年3月期については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2024年3月期(予想)については、当該株式分割後の数値を記載しております。なお、株式分割を考慮しない場合の2024年3月期(予想)の年間配当金は、1,020円となります。
- 2023年3月期の期末配当金854円には、創立60周年記念配当200円を含んでおります。

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日～2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,730,000	21.7	401,000	35.1	404,000	35.4	307,000	34.9	661.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」9ページ「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年3月期2Q	471,632,733 株	2023年3月期	471,632,733 株
期末自己株式数	2024年3月期2Q	8,808,694 株	2023年3月期	3,272,016 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年3月期2Q	465,875,522 株	2023年3月期2Q	467,586,934 株

(注)1. 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

2. 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2024年3月期2Q 1,386,684株、2023年3月期 1,502,637株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2023年11月10日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) キャッシュ・フローに関する説明	2
(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業的前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間の世界経済につきましては、資源・エネルギー価格の高騰は緩和傾向にあったものの、前連結会計年度から引き続き諸物価が上昇し、また、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げによる円安水準が継続する状況にありました。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、過去数年にわたって増加していた半導体製造装置向けの設備投資は一時的な調整局面を迎えました。しかしながら、情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的には半導体製造装置市場はさらなる成長が見込まれております。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間においては、PCやスマートフォン等の最終製品の需要の一巡や半導体メモリの在庫の調整に伴い、半導体メモリメーカーにおける生産の抑制及び設備投資の調整がおこなわれました。先端ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資についても、メモリ向け同様、一時的な調整局面にありましたが、車載や産業用途、IoT等を中心に、成熟世代向け設備投資は、社会のデジタル化を背景に、前連結会計年度に引き続き堅調に推移しました。

この結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高8,195億7千2百万円(前年同期比30.7%減)、営業利益1,785億7千8百万円(前年同期比49.0%減)、経常利益1,812億8千2百万円(前年同期比48.7%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,374億9千1百万円(前年同期比48.6%減)となりました。

なお、第1四半期連結会計期間から、報告セグメントを「半導体製造装置」の単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,882億1千6百万円減少し、1兆5,527億4千3百万円となりました。主な内容は、現金及び預金の減少1,204億5千5百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少971億7千2百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から414億6百万円増加し、3,004億9千4百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から13億2千8百万円増加し、298億8千8百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から256億2千9百万円増加し、3,086億1千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から1,198億5千2百万円減少し、2兆1,917億4千1百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ527億2千万円減少し、5,771億7千2百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少241億6千万円、未払法人税等の減少236億3千9百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ21億2千万円増加し、842億9千5百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ692億5千2百万円減少し、1兆5,302億7千2百万円となりました。主として、前期の期末配当1,337億5千4百万円の実施による減少、自己株式取得による減少1,200億2千7百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益1,374億9千1百万円を計上したことによる増加、為替換算調整勘定の増加238億6百万円、その他有価証券評価差額金の増加191億5千7百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は69.2%となりました。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ1,205億7千8百万円減少し、3,518億9千3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資107億5千1百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ1,104億5千5百万円減少し、3,626億4千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ627億6千8百万円減少の2,006億2千2百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,811億3千6百万円、売上債権及び契約資産の減少1,064億7千2百万円、未収消費税等の減少911億6千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、棚卸資産の増加853億4千6百万円、法人税等の支払額719億7千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出549億5千3百万円により、前年同期の342億1千万円の支出に対し703億5千4百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,337億5千4百万円、自己株式の取得による支出1,200億2千7百万円により、前年同期の1,212億6千9百万円の支出に対し2,549億9千9百万円の支出となりました。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間につきましては、売上高は前回予想を上回り、利益面につきましても営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益それぞれ予想を上回る結果となりました。

また、通期連結業績予想につきましても、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2023年5月11日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

2024年3月期第2四半期累計期間の連結業績

	当期上半期実績	前回予想 (2023年5月11日公表)
売上高	8,195億円 (前年同期比 30.7%減)	7,900億円
営業利益	1,785億円 (前年同期比 49.0%減)	1,610億円
経常利益	1,812億円 (前年同期比 48.7%減)	1,620億円
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,374億円 (前年同期比 48.6%減)	1,200億円

2024年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2023年5月11日公表)
売上高	1兆7,300億円 (前期比 21.7%減)	1兆7,000億円
営業利益	4,010億円 (前期比 35.1%減)	3,930億円
経常利益	4,040億円 (前期比 35.4%減)	3,950億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,070億円 (前期比 34.9%減)	3,000億円

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	473,099	352,643
受取手形、売掛金及び契約資産	464,889	367,717
有価証券	0	10,001
商品及び製品	236,795	282,847
仕掛品	161,938	157,024
原材料及び貯蔵品	253,474	308,669
その他	150,946	73,992
貸倒引当金	△184	△152
流動資産合計	1,740,959	1,552,743
固定資産		
有形固定資産	259,088	300,494
無形固定資産		
その他	28,559	29,888
無形固定資産合計	28,559	29,888
投資その他の資産		
その他	284,326	310,016
貸倒引当金	△1,340	△1,401
投資その他の資産合計	282,986	308,615
固定資産合計	570,634	638,998
資産合計	2,311,594	2,191,741

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	116,317	92,157
未払法人税等	71,177	47,538
前受金	289,169	310,492
製品保証引当金	34,382	32,944
賞与引当金	43,337	24,960
その他の引当金	3,605	734
その他	71,904	68,345
流動負債合計	629,893	577,172
固定負債		
その他の引当金	3,189	3,070
退職給付に係る負債	60,366	60,550
その他	18,618	20,674
固定負債合計	82,175	84,295
負債合計	712,069	661,468
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	1,322,203	1,324,214
自己株式	△22,033	△137,695
株主資本合計	1,433,141	1,319,490
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	107,452	126,610
繰延ヘッジ損益	△46	37
為替換算調整勘定	43,091	66,898
退職給付に係る調整累計額	3,954	3,087
その他の包括利益累計額合計	154,453	196,634
新株予約権	11,929	14,147
純資産合計	1,599,524	1,530,272
負債純資産合計	2,311,594	2,191,741

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	1,182,897	819,572
売上原価	654,081	467,531
売上総利益	528,816	352,040
販売費及び一般管理費		
研究開発費	91,313	94,678
その他	87,337	78,784
販売費及び一般管理費合計	178,651	173,462
営業利益	350,165	178,578
営業外収益		
持分法による投資利益	1,212	1,549
その他	3,983	4,339
営業外収益合計	5,195	5,889
営業外費用		
為替差損	1,293	2,494
その他	748	691
営業外費用合計	2,041	3,185
経常利益	353,319	181,282
特別利益		
固定資産売却益	2	10
特別利益合計	2	10
特別損失		
固定資産除売却損	405	155
特別損失合計	405	155
税金等調整前四半期純利益	352,916	181,136
法人税等	85,570	43,644
四半期純利益	267,346	137,491
親会社株主に帰属する四半期純利益	267,346	137,491

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	267,346	137,491
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△28,307	19,155
為替換算調整勘定	20,804	23,566
退職給付に係る調整額	△187	△863
持分法適用会社に対する持分相当額	316	322
その他の包括利益合計	△7,373	42,180
四半期包括利益	259,972	179,672
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	259,972	179,672

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	352,916	181,136
減価償却費	19,622	23,185
のれん償却額	107	36
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△4,374	△19,156
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	8,864	△1,761
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△64,681	106,472
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△69,215	△85,346
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,610	△28,588
未収消費税等の増減額 (△は増加)	44,856	91,166
前受金の増減額 (△は減少)	84,840	18,898
その他	1,514	△16,227
小計	370,840	269,814
利息及び配当金の受取額	1,854	2,779
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△109,303	△71,971
営業活動によるキャッシュ・フロー	263,391	200,622
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	581	△83
短期投資の増減額 (△は増加)	5,000	△10,000
有形固定資産の取得による支出	△32,792	△54,953
無形固定資産の取得による支出	△5,175	△3,833
その他	△1,823	△1,483
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,210	△70,354
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△1,708	△120,027
配当金の支払額	△118,833	△133,754
その他	△727	△1,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	△121,269	△254,999
現金及び現金同等物に係る換算差額	11,043	4,153
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	118,955	△120,578
現金及び現金同等物の期首残高	335,648	472,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	454,603	351,893

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2023年5月11日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第2四半期連結累計期間において115,661百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において137,695百万円となりました。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

当社グループは、「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループの報告セグメントは、従来「半導体製造装置」と「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」に区分しておりましたが、第1四半期連結会計期間から「半導体製造装置」の単一セグメントに変更しております。

この変更は、半導体製造装置市場が着実な成長を遂げ、将来的にも高い伸びが見込まれているなか、FPD製造装置事業が当社グループ全体に与える影響が軽微になっていること、また、リソースの効率的な活用を目的として、2023年4月から半導体製造装置事業にFPD製造装置事業を統合する組織再編を行ったこと等を踏まえ、当社グループの事業展開、経営資源配分等の意思決定プロセスの実態の観点から、「半導体製造装置」の単一セグメントとして一体で開示することが、当社グループの経営実態をより適切に反映するものと判断したことによるものであります。

この変更により、当第2四半期連結累計期間におけるセグメント情報の記載を省略しております。